

適用 SFP2 表面粗糙度測頭模組的 校正及功能標準件

在 CMM 上量測表面粗糙度

傳統的表面粗糙度量測都要使用手持感測器，或必須將工件移至昂貴的專用量測機器上。

而適用 REVO® 5 軸系統的 SFP2 測頭模組改變了這一切，讓表面粗糙度檢測成為 CMM 量測不可或缺的一部分，並可自動切換使用掃描、光學非接觸式及表面粗糙度量測的測頭類型。

此獨家功能可將表面粗糙度分析完全整合至單一量測報告。

校正及功能標準件

Renishaw 提供一系列產品，支援在 CMM 上使用 REVO SFP2 表面粗糙度量測測頭模組。

標準件底板可用於校正表面粗糙度模組、獨立驗證校正結果、檢查線性及端部狀況監控。

此外 Renishaw 也提供狀態檢查標準件，可在整個 CMM 空間範圍內定位光學平面及校正底板，適合用於評估機器表面粗糙度量測的能力。

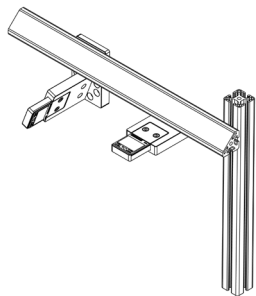
TFP 端部找正測頭是由 TP20 測頭與低觸發力模組組成，用於對應 SFP2 測頭的 C 軸，以及校正模組/固定座配置的幾何形狀。

主要優點

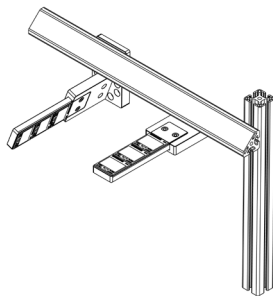
- * 提供一系列全方位工具在 CMM 上支援表面粗糙度量測
- * 校正一系列完整的表面粗糙度模組
- * 獨立的線性及校正驗證外加端部狀況監控功能
- * 機器功能測試及故障排解



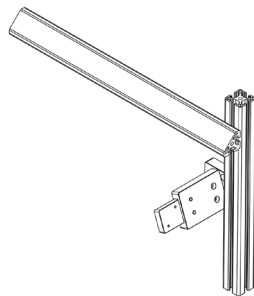
MRS2 導軌上的單一標準件



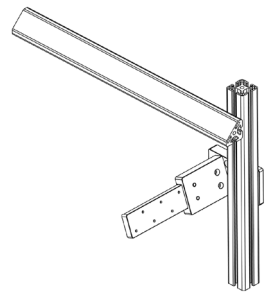
MRS2 導軌上的三個標準件



MRS2 支腳上的單一標準件

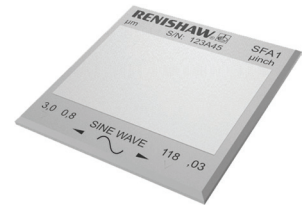


MRS2 支腳上的三個標準件

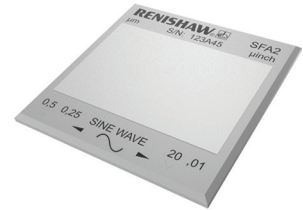


規格

校正底板 SFA1 *	
功能	用於校正 SFM 表面粗糙度模組。
表面詳細資料	3.0 μm Ra 正弦波輪廓。 電鍍鍍表面。
可追溯性	提供 UKAS 校正證書。



檢查底板 SFA2 *	
功能	用於檢查校正線性。
表面詳細資料	0.5 μm Ra 正弦波輪廓。 電鍍鍍表面。
可追溯性	提供 UKAS 校正證書。



驗證底板 SFA3 *	
功能	用於定期檢查端部狀況。
表面詳細資料	0.4 μm Ra 鋸齒波輪廓。 電鍍鍍表面。
可追溯性	提供 UKAS 校正證書。



CMM 狀況檢查標準件 OFA **	
功能	用於驗證機器功能及故障排解的維修工具。 其中包含位在立方體內部的六個光學平面，並設置安裝孔以安裝其他校正和檢查標準件。
表面詳細資料	$\lambda/20$ 熔融矽石光學平面。 直徑 50 mm。
可追溯性	光學平面隨附校正證書。



位置選項：

- * SFA1、SFA2 及 SFA3 可固定至 MRS2 導軌、MRS2 支腳或 OFA 標準件。這類標準件及固定架可隨完整系統套件供應，也可以個別供應。
- ** OFA 可直接安裝至 CMM、治具基板或通用的校正塔。OFA 僅限於特殊訂單供應。請聯絡 Renishaw 了解更完整資訊。

www.renishaw.com.tw/SFP2

 #renishaw

+886 4 2460 3799

 taiwan@renishaw.com

© 2024 Renishaw plc 保留所有權利。RENISHAW® 及測頭標誌為 Renishaw plc 註冊商標。Renishaw 產品名稱、稱謂及其「apply innovation」標記為 Renishaw plc 或其子公司註冊商標。
其他品牌、產品或公司名稱為各自所有者的商標。

Renishaw plc 於英格蘭及威爾斯註冊登記。公司編號：1106260。註冊辦公室：New Mills, Wotton-under-Edge, Glos, GL12 8JR, UK。

儘管本公司於發布本文件時已盡相當之努力驗證其正確性，於法律允許範圍內，本公司概不接納以任何方式產生之擔保、條件、聲明及賠償責任。

零件訂貨號：H-1000-2115-02-A
發佈日期：01.2024